



## 用于高性能SMT应用的无铅焊膏系列

针对SMT工艺要求严苛的应用而开发的卓越的焊膏系列

Microbond® SMT712免清洗焊膏系列采用先进的无铅焊膏配方，可确保卓越的印刷性能。

对于诸如智能手机或混合电路等要求苛刻的复杂电子产品应用，不含卤素助焊剂零配方具有足够的活性，可在空气氛围内确保优异的润湿效果。

# Microbond® SMT712

## 适用于SMT应用

### 主要特点

- 可在空气回流内确保优异的湿润效果
- 低空洞率表现
- 稳定的大批量印刷性能
- 抗焊珠配方
- 超低透明助焊剂残留物
- 可有效的避免枕头效应

### 标准的产品规格

<b>SMT712 焊膏</b>
免清洗型
不含卤素
4号和5号焊粉
ROLO
SAC305 合金

#### 美洲地区

电话 +1 610 825 6050  
electronics.americas@heraeus.com

#### 亞太

电话 +65 6571 7649  
electronics.apac@heraeus.com

#### 中国

电话+86 53 5815 9601  
electronics.china@heraeus.com

#### 歐洲、中東和非洲

电话 +49 6181 35 4370  
electronics.emea@heraeus.com

本文所述事实与技术数据均由贺利氏利用最新知识和现代实验设备根据通用实验流程测定得出。文中信息均为出版前最新版本(可索要最新版本文件)尽管数据均准确无误,但贺利氏对上述数据是否得到合理引用或因引用上述数据导致的任何侵权后果均不承担任何责任(除非事先以协议的形式征得明确的书面同意)。使用者应根据本文所提供的数据针对特定应用对材料适用性进行测试。贺利氏标识, Heraeus, 贺利氏, 和AgCoat® Prime 图形标志是贺利氏控股有限公司或其附属公司的商标或注册商标。所有权利归贺利氏所有。